

中信建投证券股份有限公司
关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京昂瑞微电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：张悦	联系方式：010-65608402 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：汪家富	联系方式：010-56052427 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕2348 号文”批准，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（简称“公司”或“昂瑞微”）向社会公开发行人民币普通股 2,488.2922 万股，每股发行价格为人民币 83.06 元，募集资金总额为人民币 206,677.55 万元，扣除发行费用人民币 13,445.28 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 193,232.27 万元。本次公开发行股票于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	保荐人、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
2	保荐人、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公	保荐人已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

	工作内容	持续督导情况
	平。 保荐人、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。保荐人、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐人已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。保荐人已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐人、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐人和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司及其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
4	保荐人、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐人、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐人、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐人、保荐代表人应当发表意见予以说明。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解公司经营、股票交易等情况，对公司开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐人、保荐代表人应当督促上	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

	工作内容	持续督导情况
	市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	
7	保荐人、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐人、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人对上市公司募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并对上市公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行了现场检查，出具了关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现昂瑞微存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）技术风险

1、技术和产品迭代风险

公司所处的集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度较快，需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级研发新产品，以保持产品竞争优势。若公司未能及时准确把握技术的变化趋势和发展方向，持续推出具有商业价值和竞争力的新产品，将导致公司错失新的市场商机，无法维持新老产品的滚动迭代及业务的持续增长。

公司射频前端芯片产品主要下游应用领域为移动智能终端行业，其具有通信技术迭代速度较快、产品需求变化较快、产品技术及质量要求较高等特点，因此射频前端行业具有产品迭代速度较快、产品验证周期较长、市场竞争格局复杂多变等特点，公司需及时推出满足市场需求的新产品并保持前瞻性，以保持市场竞争力。

公司采用 Fabless 模式，研发阶段需依赖外协工厂的通用工艺进行验证测试，这在一定程度上制约了自身特色工艺的迭代效率。相较 IDM 模式企业能实现全

环节协同与快速工艺调整，若外协工厂无法高效满足验证需求，将因设计与制造环节脱节而延长研发周期，导致产品迭代滞后。当前射频前端行业处于国产化替代关键期，若公司技术升级与产品迭代不及预期，无法满足市场需求，或遭遇颠覆性技术替代，将面临产品升级风险，进而削弱行业地位与市场竞争力。

2、产品研发不及预期的风险

公司主要从事射频前端芯片、射频 SoC 芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售，需要进行持续性的产品研发并在研发过程中投入大量的资金和人员，以应对不断变化的市场需求。

由于技术的产业化和市场化始终具有一定不确定性，如公司未来在研发方向上未能做出正确判断，或者在研发过程中未能突破关键技术、未能满足产品性能指标要求，或者所开发的产品不契合市场需求，公司将面临研发未达预期且前期研发投入无法收回的风险，对公司的产品销售和财务状况造成不利影响。

3、知识产权风险

集成电路行业属于技术密集型行业，公司坚持自主创新的研发战略，重视自主知识产权的申报和保护。但未来不排除在业务开展过程中出现专有技术、专利或集成电路布图设计等被盗或不当使用、知识产权被监管机构宣告无效或撤销，或与竞争对手产生知识产权纠纷或诉讼的可能。同时，虽然公司注意尊重和保护第三方知识产权，但仍不排除由于境内外知识产权法律体系和认知差异、公司员工理解偏差等因素而引发的知识产权纠纷、争议或诉讼风险，进而影响公司日常经营。

（二）经营风险

1、客户相对集中和客户拓展不及预期的风险

公司的下游终端应用领域主要包括移动智能终端及无线外设、智能家居、健康医疗、智慧物流等物联网场景。其中，公司射频前端芯片产品已在知名品牌终端客户实现规模销售。同时，射频 SoC 芯片产品已导入多家工业、医疗、物联网等知名客户。头部品牌终端客户具有采购规模大、高端需求多、质量要求高等特点，对推动公司未来的收入增长、盈利提升起到重要作用。

射频通信产品下游客户的市场集中度较高，导致公司的客户呈现较高的集中度。受客户整体战略规划、提货节奏、市场偏好及市场竞争等多重因素的影响，公司与现有主要客户的合作情况可能出现不利变化，公司在新客户拓展方面的进

度和效果也可能不及预期。若公司未能准确把握下游客户的应用需求，主要产品在终端客户中验证失败或者导入进度缓慢，可能导致客户拓展不及预期，亦有可能无法保持现有的业务规模 and 市场份额，进而对公司持续竞争力、成长性及未来经营业绩产生不利影响。

2、大客户收入下滑的风险

报告期内，全球智能手机市场整体出货承压，下游终端客户备货、提货节奏同步放缓，传统手机射频相关业务收入有所回落。此外，若公司产品未能满足大客户的技术要求和应用需求、产品验证失败，均可能导致客户下调整体采购需求，公司存在未来一定时期内大客户收入下滑的风险。

3、供应链不稳定的风险

公司采用 Fabless 的经营模式，专注于半导体芯片的研发、设计及销售，涉及晶圆制造、芯片封装测试等生产环节委托第三方完成。公司的生产性采购主要包括晶圆制造和封装测试等。

受全球贸易政策、国家产业政策及行业发展预期、地缘政治冲突等多种因素影响而具有不稳定性，若主要供应商终止与公司的合作关系，或因产能紧张等因素作出其他不利于公司经营的要求，而公司未能及时拓展新的供应商进行有效替代，则将面临原材料或代工服务供应短缺、产能不足的风险。特别地，当前存储芯片、高端基板、封装测试等关键原材料和加工环节价格呈现上行趋势，若涨价幅度及持续时间超出预期，将直接推高公司生产成本；同时，随着 AI 产业链需求爆发，芯片及先进封装产能的紧张情况可能会加剧，导致公司获取核心产能的等待周期延长。上述情况若未能得到有效缓解，可能导致公司不能按期交货，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

4、产品质量风险

公司的射频前端模组产品连接天线模组和射频收发机，主要负责射频信号的接收和发射，直接影响移动智能终端的信号收发质量，在终端应用中具有举足轻重的作用，客户对公司产品的质量及可靠性要求较高。若未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，或上游供应商提供的产品或者服务出现质量及可靠性问题，可能损害公司的品牌声誉，对公司与下游客户的合作产生不利影响。

5、优秀人才流失的风险

公司为采用 Fabless 经营模式的技术创新型公司，所处行业具有技术密集型和人才密集型的特征，具备扎实理论知识、丰富行业经验以及研发创新能力的优秀人员在技术研发、产品推广、生产运营等方面具有关键作用，该等优秀人员的引进及留用培养对于公司的经营发展具有重要意义。

近年来，我国大力发展集成电路产业，对集成电路行业研发、产品、销售人员的需求大幅上升，集成电路行业整体面临较大的专业人才缺口，具有丰富经验的行业人才炙手可热。公司提供了具有市场竞争力的薪酬水平及相关激励政策，以更好地实现人才激励。未来，若发生优秀人才大量流失的情况，将对公司的研发实力、生产经营和市场竞争力产生不利影响。

（三）财务风险

1、存货金额较大及跌价的风险

报告期末，存货余额为 87,601.10 万元，公司计提的存货跌价准备为 21,301.49 万元，公司存货余额相对较高，存在一定的跌价风险。2026 年上半年，公司计提存货减值损失为 5,208.36 万元，主要系客户需求变化、汇率变动、原材料成本波动等导致部分存货可变现净值低于账面价值，相应计提减值准备。未来若公司下游客户需求、市场竞争格局、成本等进一步发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理导致存货无法顺利实现销售或按合理的价格实现销售，则将存在存货余额增加且存货跌价准备金额进一步扩大的风险。

2、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额为 11,253.57 万元。公司按照会计政策对应收账款计提坏账准备，报告期末，公司计提的坏账准备余额为 32.53 万元。若未来公司部分客户经营情况或信誉情况发生重大不利变化，或是公司基于历史情况估计的预期信用损失率未能反映应收账款真实坏账风险，则公司需进一步计提应收账款坏账准备，公司将面临应收账款坏账损失金额增加的风险。

3、政府补助减少和政策变化的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 932.91 万元。若未来公司享受的政府补助政策取消，或政府补助政策、补助力度等发生不利调整，将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。

4、毛利率相对较低及下降风险

一方面，公司产品销售单价受美系、日系领先厂商同类产品的市场定价、产

品及技术先进性、客户议价能力以及过往销售价格等因素影响；另一方面，产品单位成本受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响，亦存在一定的波动。未来，若公司所处行业竞争进一步加剧，供应链侧成本大幅上涨，或者主营产品不能继续保持行业较好水平，将可能导致公司无法进一步改善毛利率，对盈利能力产生不利影响。

5、汇率波动风险

报告期内，美元对人民币汇率存在一定波动。公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，主要以美元作为结算货币。随着公司境外业务快速增长，若国内外政治、经济环境发生变化，汇率变动将存在较大不确定性。未来，若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

（四）行业风险

1、行业竞争加剧风险

射频前端芯片行业，一方面，国外射频芯片龙头企业 Skyworks、Murata 等多采取 IDM 业务模式，该等竞争对手起步较早、技术实力雄厚，且凭借多年的研发投入及大规模的资本性支出，在产品布局、工艺能力、成本等方面有较大优势，拥有对供应链较强控制能力；另一方面，受益于产业政策及下游终端领域国产趋势的推动，较多的资本及人才进入射频芯片领域，国内射频前端行业正快速发展，国内厂商面临在中低端市场竞争加剧的情况。

射频 SoC 行业，虽然受益于政策支持与物联网等需求增长呈现快速发展态势，但同时面临行业参与者数量增加，国内外厂商在功耗、集成度、连接稳定性等方面竞争加剧，且高端市场仍由国际龙头主导，本土企业在高端场景突破与生态话语权方面存在差距的情况。此外，蓝牙 SoC 技术迭代节奏快，蓝牙标准持续升级、多协议替代与融合的趋势明显，对企业持续研发投入、技术路线判断提出更高要求，行业整体发展面临一定挑战。

未来，若公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，提升技术实力并缩短与国际头部厂商的技术差距，顺应下游需求开发新产品并优化客户结构，则公司在市场竞争中将会处于不利的地位，进而使得公司收入、毛利、市场占有率下滑。

2、行业周期风险

公司所处行业为集成电路设计业，主要产品包括射频前端芯片、射频 SoC 芯片等，产品应用于智能手机、智能穿戴、智能家居等消费电子领域，近年来产

品技术快速发展，终端产品更新换代较快，若公司不能紧跟行业发展趋势，产品市场发展不及预期，下游应用领域自身的发展受到行业周期因素的冲击，则可能无法对公司的产品需求形成有效的支撑，进而影响到公司的业绩。

晶圆生产、封装等产业由于产能建设周期较长，容易在产能不足和产能过剩之间不断徘徊，进而影响到集成电路设计企业的发展。当供应链产能出现周期性紧缺情况下，公司如无法通过与供应商深度合作的方式实现产能优先供应，则可能将面临产品交付不稳定、产品毛利降低等问题，对公司的业绩和市场认可度都会造成影响。

3、下游消费电子行业市场需求放缓风险

公司射频前端芯片下游终端应用领域主要为智能手机，并正在重点拓展智能汽车、手机卫星通信等领域；射频 SoC 芯片下游应用领域主要为无线外设、智能家居、健康医疗、智慧物流等，产品下游市场集中于消费电子领域。

受宏观经济波动、地缘政治冲突等因素影响，消费电子行业需求曾出现阶段性放缓；2023 年下半年以来，随着 AI 终端渗透率提升及换机周期推进，市场需求呈现波动性变化。与此同时，上游存储等关键材料价格波动可能传导至终端产品售价，若手机厂商因此上调产品价格，或在一定程度上影响消费者的换机意愿，对市场需求恢复形成压力。

总体而言，公司未来长期可持续发展仍会受到消费电子市场的整体影响，如果未来下游消费类电子领域不能企稳回升甚至进一步下滑，则可能导致公司经营业绩无法稳定增长甚至下滑。

4、产业政策变化的风险

半导体行业是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营情况将会面临更多的挑战，可能对公司业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

近年来，国际政治经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级，使得国际贸易环境存在诸多的不稳定因素。集成电路产业链因全球化程度较高，成为受影响较为严重的领域之一。

目前境外企业在全中国集成电路产业链占据较大的市场份额，公司存在一定规

模的境外销售、采购情形。鉴于集成电路行业的全球化分工及各环节供应商集中度较高等特点，公司无法排除未来国际贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温、部分国家或地区出台对公司不利的限制政策等风险，上述情形可能会导致公司从晶圆代工、封装测试再到终端芯片产品的销售受限，最终对公司的生产经营产生不利影响。

（六）其他重大风险

1、设置特别表决权股份的特殊公司治理安排的风险

2023年3月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司设置特别表决权股份方案的议案》，设置了特别表决权股份，并相应修订了《公司章程》。

根据《公司章程》中有关特别表决权的约定，除股东对特定事项行使表决权时每一A类股份享有的表决权数量与每一B类股份享有的表决权数量相同以外，每一A类股份享有的表决权数量为每一B类股份享有的表决权数量的十倍。截至报告期末，通过设置特别表决权机制，公司实际控制人钱永学直接及间接控制公司52.4783%的表决权。

特别表决权机制下，实际控制人能够决定公司股东会的普通决议，对股东会特别决议也能起到重大影响，限制了除实际控制人外的其他股东通过股东会对公司重大决策的影响。在特殊情况下，实际控制人的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在损害其他股东，特别是中小股东利益的风险。

2、内控体系建设及内控制度执行的风险

公司已根据《公司法》《证券法》及《上市规则》，建立健全了符合上市公司规范的内部控制体系。但鉴于该体系建立及运行时间较短，且需随公司业务发展、监管环境变化及组织架构调整持续完善，若公司未能及时优化内控体系或相关制度未能有效执行，可能影响公司生产经营的合规性与运作效率，进而对公司经营管理目标的实现产生不利影响。

3、技术授权风险

公司作为专注于射频前端芯片、射频SoC芯片的集成电路设计企业，在研发过程中需使用电子设计自动化软件（EDA）工具，并取得EDA供应商的技术授权。目前全球EDA市场仍由国际巨头主导，呈现寡头竞争格局，其EDA工具在模拟、射频、数字电路设计等细分功能领域具有显著技术优势。

若国际贸易摩擦进一步升级，或相关 EDA 供应商因出口管制、商业策略调整等原因取消或限制对公司及其子公司的技术授权，将可能导致公司研发设计工作受阻、产品流片进度延误、现有设计工具无法正常使用，进而对公司业务发展和经营业绩产生重大不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，昂瑞微不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	773,147,857.26	843,591,256.80	-8.35
归属于上市公司股东的净利润	156,059,091.97	-40,299,465.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,340,166.54	-61,066,411.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-196,475,441.93	75,122,503.75	-361.54
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,938,131,759.88	2,786,780,792.83	5.43
总资产	3,473,033,191.91	3,529,725,863.71	-1.61

公司主要财务指标如下表所示：

单位：元

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.57	-0.54	不适用
稀释每股收益 (元/股)	1.57	-0.54	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.51	-0.82	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	5.45	-4.21	增加 9.66 个百分点
扣除非经常性损益	-5.25	-6.38	增加 1.13 个百分点

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
后的加权平均净资产收益率 (%)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	21.11	16.40	增加 4.71 个百分点

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 77,314.79 万元，较上年同期降低 8.35%；归属于上市公司股东的净利润为 15,605.91 万元，较上年同期提升 19,635.86 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,034.02 万元，较上年同期减少 8,927.38 万元。营业收入同比下滑主要系报告期内，全球智能手机市场整体出货承压，下游终端客户备货、提货节奏同步放缓，传统手机射频相关业务收入有所回落；与此同时，公司基于中长期发展目标主动优化业务结构，战略性收缩了部分低毛利、竞争激烈的项目。面对业绩下滑的挑战，公司将持续加强技术储备，拓展市场增长点，一方面，积极拓宽新兴业务赛道，加速手机卫星通信、智能汽车、低空经济等领域产品布局，前瞻性布局新一代通信技术；另一方面，持续助推射频 SoC、其他模拟芯片等第二、第三发展曲线，相关产品线收入合计较 2025 年上半年同比增长 51.24%；同时，公司正持续加大海外市场拓展力度，以全面提高公司综合竞争力。

2、2026 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,647.54 万元，同比降低 27,159.79 万元，主要系报告期内公司提前加大晶圆等原材料备货采购规模，向供应商购买原材料支付的现金同比增加，以及研发费用等各项费用增加所致。

3、2026 年 1-6 月，公司基本每股收益较上年同期提升 2.11 元；稀释每股收益较上年同期提升 2.11 元；加权平均净资产收益率较上年同期增加 9.66 个百分点。主要系公司参与盛合晶微 IPO 战略配售，对应金融资产公允价值变动，净利润上升所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司始终专注于射频、模拟芯片的研发与设计，经过多年深耕，已在技术、产品、客户、供应链及团队等方面形成了系统性的核心竞争优势，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

（一）产品优势：全品类布局推进国产迭代

公司拥有涵盖 5G、车载通信及手机卫星通信等领域的全系列射频前端解决方案，可为智能手机、智能汽车等终端提供包括 L-PAMiD、L-PAMiF、DiFEM、车载通信、手机卫星通信 PA 等在内的数十款产品，形成了完整的 5G 终端产品解决方案矩阵。

在 5G 射频前端高集成度模组领域，公司依托多工艺平台设计能力和长期积累的模组化技术，在国内率先实现 Phase7LE L-PAMiD 模组产品对主流品牌客户大规模量产出货，打破了国际厂商垄断。在此基础上，公司推出高集成度的 Phase8L 模组产品，将 5G Low/Mid/HighBand 与 GSM 功能集成于单一模组，已在品牌客户量产；同时，公司与客户共同定义下一代更小、更薄、效率更高的 L-PAMiD 模组，开展针对多家品牌客户的定制化验证。

在车载及手机卫星通信等新兴领域，公司多款车载产品已通过 AEC-Q100 车规级认证，具备宽温、高可靠特性并在知名车企量产应用；手机卫星通信产品通过持续技术迭代，使用功率合成技术和倒扣封装技术，大幅降低手机卫星通信产品尺寸和面积，兼容北斗、天通和卫通三种卫星通信系统，降低了射频方案复杂度、面积、成本，支持手机终端等小型化，进一步拓展了品牌手机客户的覆盖，多款产品已经实现规模出货；同时，公司积极拓展手机卫星通信场景下的产品类型，支持卫通的高性能 LNA 产品已对品牌客户量产出货。

（二）技术优势：深厚全面的技术积累

公司秉持技术创新为核心理念，经过多年研发投入，在射频前端模组化、CMOS 功率放大器、射频 SoC 低功耗及多工艺协同等领域形成了深厚的技术积累。公司持续推动体硅 CMOS 射频功率放大器技术的研发，相关技术荣获北京市科学技术三等奖；射频 SoC 芯片在电子价签等应用场景中可实现约 10 年续航，充分体现了公司的技术优势。

在射频前端模组化这一核心技术领域，公司依托 PA、LNA、射频开关等器件的量产经验，以及隔离度优化、仿真平台化、可靠性验证等关键能力，已量产出货 L-PAMiD、L-PAMiF 等高集成度模组。公司 L-PAMiD 产品采用高性能 POI SAW 技术、温补 SAW 技术及共型屏蔽技术，有效解决模组辐射杂散、带间干扰等行业难题，最大支持 4 路载波聚合接收，大幅提升下行速率。2026 年，公司积极开展低压氮化镓（GaN）功放技术前瞻预研，重点布局大功率、高频率、高

效率相关产品开发，并与国内头部客户开展深度技术合作，持续夯实新一代功率器件技术储备。

公司注重生产工艺的积累与协同，构建了覆盖 CMOS、GaAs、SiGe、SOI 等多种工艺的底层技术平台，实现射频前端与射频 SoC 两大产品线的 IP 共享与协同研发，进一步助力公司的技术积累。

（三）客户优势：深度协同构筑合作壁垒

公司坚定执行大客户战略，经过多年积累，与全球多家品牌终端客户建立了长期稳定的合作关系。射频前端产品已广泛应用于多家知名手机品牌客户；射频 SoC 产品也已导入知名工业、医疗、物联网等头部客户，覆盖无线外设、智能家居、健康医疗、智慧物流等多元物联网应用场景。

公司与核心客户深度协同，加强在产品定义阶段即与客户开展联合研发，提供定制化开发服务的合作模式。这不仅能满足客户多方面的个性化需求，也使得公司能够第一时间掌握行业前沿技术动向和产业最新规划，优先获得客户需求信息及验证支持。

通过定制化和联合开发的产品模式，公司与品牌客户形成了高壁垒的合作关系。客户在研发初期即深度介入，后续切换供应商的转换成本高、验证周期长，这种紧密的共生关系为公司业务的持续稳定增长提供了坚实保障。

（四）供应链优势：构建自主可控体系

公司注重产品质量的前端把控，晶圆制造和封装测试等环节均由境内外知名厂商完成。在晶圆代工方面，公司与国际、国内领先企业均建立了长期良好合作关系，构建了稳定可靠的双供应链体系；在封装测试方面，国内知名封测企业为公司提供稳定的产能支持。

公司在发展 5G 过程中，坚持供应链多元化，在供应链安全层面加强投入，完成了关键复杂模组产品的多元化布局，与国产供应链厂商共同攻关关键工艺，加强供应链安全。

（五）团队优势：经验丰富的研发团队

芯片设计行业是技术密集型产业，高素质研发人才的培养周期较长，经验丰富、素质过硬的研发团队是公司维持市场竞争优势的基础。公司高度重视研发人才的引进和培养，已形成了规模适度、结构合理的人才梯队。

公司核心技术人员均拥有超过十年芯片设计领域工作经历，对射频前端、射

频 SoC 等领域有着深入透彻的理解。同时，公司建立了完善的人才培养与激励机制，通过定期及不定期的专业技能培训、项目管理培训、新员工入职培训等，持续提升团队专业能力。

七、研发支出变化及研发进展

公司高度重视技术创新，持续保持研发投入。报告期内公司研发费用为 16,319.64 万元，较上年同期增加 17.95%。截至 2026 年 6 月末，公司研发人员人数 277 人，同比增长 35.78%。

公司高度重视知识产权保护，构建了涵盖专利、商标、软件著作权、集成电路布图设计、商业秘密等在内的完善保护体系。截至 2026 年 6 月 30 日，公司现行有效知识产权累计 371 项，其中发明专利 77 项，实用新型 74 项，软件著作权 6 项，另有集成电路布图设计专有权、商标 214 项。报告期内，公司获得新增授权知识产权 17 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 12 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	206,677.55
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	13,445.28
二、募集资金净额	193,232.27
减：	
以前年度已使用金额	353.87
本年度使用金额	19,618.91
暂时补流金额	0
现金管理金额	155,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入（注 1）	310.43

其他-未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	48.32
三、报告期期末募集资金余额	18,618.16

注 1：募集资金利息收入为存款利息收入与理财投资收益合计；

注 2：本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，根据国家企业信用信息公示系统网站，沐盟科技集团有限公司所持北京鑫科 0.0492 万元出资额被重庆市江北区人民法院冻结，冻结期限自 2024 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日。沐盟科技集团有限公司系北京鑫科的有限合伙人，其持有的北京鑫科出资额被冻结不影响公司实际控制人持有公司的股份，不会导致公司控制权发生变更或导致公司实际控制人变化，亦不会影响公司控制权稳定。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 张悦

张悦

汪家富

汪家富

